



2026年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2025年8月7日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <https://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長執行役員 (氏名) 三浦 宗男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経営企画本部長 (氏名) 中西 和彦

TEL 075 - 692 - 0251

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第1四半期	8,080	39.0	581		732		528	
2025年3月期第1四半期	13,253	39.3	2,212	140.3	2,420	112.5	1,690	115.9

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 351百万円 (84.3%) 2025年3月期第1四半期 2,240百万円 (10.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第1四半期	7.05	
2025年3月期第1四半期	22.54	

(注) 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第1四半期	86,616	60,239	69.5
2025年3月期	83,228	61,386	73.8

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 60,239百万円 2025年3月期 61,386百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期		0.00		20.00	20.00
2026年3月期					
2026年3月期(予想)		0.00		20.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	23,000	16.1	1,710	67.5	1,710	67.3	1,197	68.7	15.96
通期	56,000	4.7	9,800	10.4	9,800	4.3	6,860	15.5	91.46

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 - 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - 以外の会計方針の変更 : 無
 - 会計上の見積りの変更 : 無
 - 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)				
期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2026年3月期1Q	75,140,556 株	2025年3月期	75,140,556 株
期末自己株式数	2026年3月期1Q	130,550 株	2025年3月期	134,055 株
期中平均株式数 (四半期累計)	2026年3月期1Q	75,008,396 株	2025年3月期1Q	74,997,125 株

(注) 1. 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数 (普通株式) を算定しております。

2. 期末自己株式数には、「株式給付信託 (J - ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託 (J - ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 1. 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 2. 決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、成長を維持しているものの、米中両国の景気減速や貿易摩擦の再燃、政策の不確実性、地政学リスクの高まりなどが影響し、金利動向や金融市場の不安定化への懸念が強まるなど、全体的に鈍化傾向が見られました。

半導体業界においては、生成AI向けの需要が堅調に推移する一方で、米国の関税政策の強化により、スマートフォンや自動車向けなど、生成AI以外の分野における需要や投資が依然として低水準にとどまっています。

このような事業環境のもと、当社グループの業績は、米国の関税政策に対する不透明感の高まりを受け、お客様が設備投資に慎重な姿勢を示されたことに加え、一部地域におけるお客様の工場への納入スケジュールが第2四半期にずれ込んだことなどの影響を受け、前年同期比で減収となりました。なお、足元の受注環境は中国において半導体の内製化に向けた動きが進む中、回復基調にあります。また、生成AI分野における需要の高まりを背景に、次世代メモリ関連製品向けのモールドディング装置「CPM1080」の顧客基盤が拡大しており、これまで導入実績のなかった主要メーカーへの採用も決定されるなど、着実に改善が進んでいます。第1四半期は当初の想定を下回る売上高水準となりましたが、第2四半期にかけて中国、韓国、台湾、その他アジア地域において、設備投資の再開や需要の回復が進む見通しです。

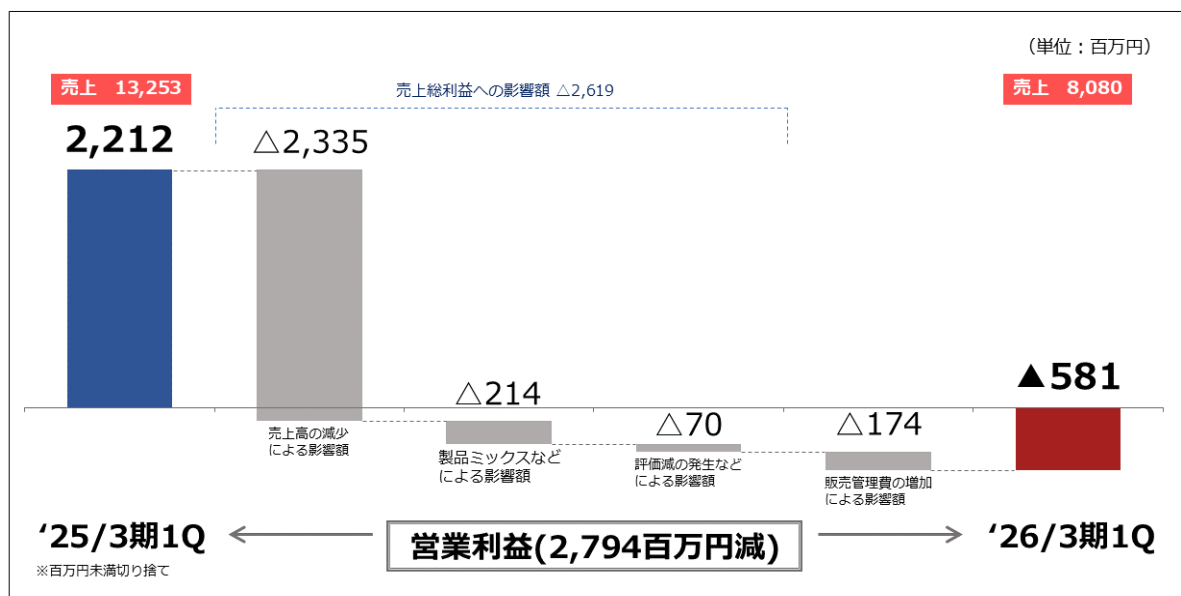
利益につきましては、売上高が一時的に収益確保の目安となる水準に届かなかったことから、各段階利益で赤字となりました。なお、第2四半期においては、上記のとおり売上高の回復が見込まれており、第2四半期連結累計期間では黒字化する見通しです。

当第1四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	80億80百万円（前年同期比51億72百万円、39.0%減）
営業損失	5億81百万円（前年同期は営業利益22億12百万円）
経常損失	7億32百万円（前年同期は経常利益24億20百万円）
親会社株主に帰属する四半期純損失	5億28百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益16億90百万円）

当第1四半期連結累計期間の営業損失の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の減少による影響額	23億35百万円減
製品ミックスなどによる影響額	2億14百万円減
評価減の発生などによる影響額	70百万円減
販売管理費の増加による影響額	1億74百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[半導体製造装置事業]

半導体製造装置事業における経営成績は、中国地域及びその他アジア地域を中心に、米国の関税政策の影響によりお客様の投資意欲が減退し、装置納入台数が減少したことから、売上高は72億2百万円（前年同期比50億56百万円、41.2%減）となりました。利益につきましては、売上高の減少に伴い、営業損失6億7百万円（前年同期は営業利益21億64百万円）となりました。

[メディカルデバイス事業]

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療機器向けの成形品や組立品の需要が堅調であったことから、売上高5億94百万円（前年同期比24百万円、4.3%増）となりました。一方、利益につきましては、生産体制の強化に伴う人件費の増加などにより、営業利益1億2百万円（前年同期比23百万円、18.8%減）となりました。

[レーザ加工装置事業]

レーザ加工装置事業における経営成績は、主力製品であるレーザトリマ装置に対するお客様の設備投資が先送りされたことなどの影響により、売上高は2億83百万円（前年同期比1億40百万円、33.2%減）、営業損失75百万円（前年同期は営業損失78百万円）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ33億87百万円増加し866億16百万円となりました。これは、売上債権が減少した一方で、現金・預金及び棚卸資産が増加したことによるものです。

負債総額は、前連結会計年度末に比べ45億34百万円増加し263億76百万円となりました。これは、法人税等の支払いにより未払法人税等が減少した一方で、借入金及び前受金が増加したことによるものです。

純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ11億46百万円減少し602億39百万円となりました。

その結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は69.5%（前連結会計年度末比4.3ポイント減少）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第1四半期の売上は、米国の関税政策に対する不透明感の高まりを背景に、設備投資に慎重な姿勢が見られたことや、お客様の設備納入スケジュールの後ろ倒しなどの影響により想定を下回る結果となりました。一方で、受注環境は改善傾向にあり、第2四半期以降は設備投資の再開や需要の回復が進む見通しです。以上を踏まえ、連結業績予想につきましては、2025年5月9日の「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,338,921	23,605,451
受取手形及び売掛金	11,391,221	9,725,205
電子記録債権	351,247	67,660
リース債権及びリース投資資産	19,965	17,796
商品及び製品	3,828,829	5,468,836
仕掛品	10,223,352	10,615,182
原材料及び貯蔵品	1,795,319	1,831,747
その他	1,709,806	1,298,739
貸倒引当金	△6,364	△7,596
流動資産合計	50,652,299	52,623,024
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	22,949,252	23,123,051
減価償却累計額	△13,670,130	△13,833,223
建物及び構築物（純額）	9,279,121	9,289,827
機械装置及び運搬具	18,094,025	18,676,965
減価償却累計額	△12,434,302	△12,638,155
機械装置及び運搬具（純額）	5,659,723	6,038,809
土地	6,566,490	6,678,424
リース資産	1,685,684	1,709,228
減価償却累計額	△509,906	△528,788
リース資産（純額）	1,175,777	1,180,440
建設仮勘定	829,705	873,310
その他	5,248,194	5,355,341
減価償却累計額	△4,258,128	△4,355,245
その他（純額）	990,066	1,000,095
有形固定資産合計	24,500,885	25,060,908
無形固定資産	1,421,284	1,427,552
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	678,782	693,766
その他	5,975,234	6,811,184
投資その他の資産合計	6,654,017	7,504,951
固定資産合計	32,576,186	33,993,411
資産合計	83,228,486	86,616,435

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,551,525	2,988,315
電子記録債務	28,887	30,091
短期借入金	7,000,000	11,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,120,000	1,120,000
未払法人税等	1,222,764	561,849
製品保証引当金	313,722	298,374
賞与引当金	1,168,008	765,558
役員賞与引当金	117,231	21,132
その他	4,487,804	6,222,722
流動負債合計	18,009,944	23,008,043
固定負債		
長期借入金	1,370,000	1,090,000
退職給付に係る負債	1,014,238	1,022,709
株式給付引当金	82,967	101,711
その他	1,364,968	1,154,189
固定負債合計	3,832,173	3,368,609
負債合計	21,842,118	26,376,652
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,969,261	8,969,261
資本剰余金	464,571	464,571
利益剰余金	45,479,594	43,448,774
自己株式	△115,241	△111,496
株主資本合計	54,798,186	52,771,112
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,817,381	3,313,266
為替換算調整勘定	3,716,815	4,111,142
退職給付に係る調整累計額	53,984	44,263
その他の包括利益累計額合計	6,588,181	7,468,671
純資産合計	61,386,368	60,239,783
負債純資産合計	83,228,486	86,616,435

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	13,253,020	8,080,222
売上原価	8,479,218	5,926,361
売上総利益	4,773,802	2,153,860
販売費及び一般管理費	2,561,157	2,735,247
営業利益又は営業損失(△)	2,212,644	△581,386
営業外収益		
受取利息	22,016	26,635
受取配当金	53,742	62,195
為替差益	75,516	—
雑収入	88,963	94,755
営業外収益合計	240,239	183,586
営業外費用		
支払利息	20,322	27,381
為替差損	—	288,478
雑損失	11,894	18,601
営業外費用合計	32,216	334,461
経常利益又は経常損失(△)	2,420,667	△732,262
特別利益		
固定資産売却益	—	297
特別利益合計	—	297
特別損失		
固定資産売却損	98	1,933
固定資産除却損	2,913	398
投資有価証券評価損	6,341	—
特別損失合計	9,353	2,331
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	2,411,313	△734,296
法人税等	720,914	△205,422
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,690,398	△528,874
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	1,690,398	△528,874

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,690,398	△528,874
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,079,683	495,884
為替換算調整勘定	1,644,358	394,326
退職給付に係る調整額	△15,003	△9,721
その他の包括利益合計	549,671	880,490
四半期包括利益	2,240,070	351,615
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,240,070	351,615

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

当第1四半期連結会計期間において、TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED、TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD. を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	631,369千円	689,605千円
のれんの償却額	38,438千円	35,650千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自2024年4月1日 至2024年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	12,258,969	569,358	424,692	13,253,020
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	12,258,969	569,358	424,692	13,253,020
セグメント利益又は損失（△）	2,164,855	126,173	△78,384	2,212,644

(注) セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自2025年4月1日 至2025年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	7,202,441	594,088	283,692	8,080,222
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	7,202,441	594,088	283,692	8,080,222
セグメント利益又は損失（△）	△607,908	102,507	△75,985	△581,386

(注) セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。